

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

## 北京赛微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国信证券 连欣然                      华福证券 郭其伟 申万电子 杨紫璇                      中信证券 江李瑞麟 中航证券 赵晓琨                      国泰海通 徐婷 中邮证券 徐铭婉                      浙商计算机 张致远 国惠基金 侯文均                      新华基金 张帅 建信基金 许晴晖                      易方达基金 袁方 财达资管 杨一言                      国寿资产 李宗燃 国泰租赁 田永新                      至御科技 刘全金 江西金控 吴伊尹、杨晨              陕西产投 巨渊、刘于嘉 苗氏药业 黄孝云、兑镇霞          山东发展租赁 薛一凡
时间	2026年4月23日 14:00-17:00
地点	北京经济技术开发区科创八街21号院 赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司三楼报告厅
上市公司接待人员姓名	董事长：杨云春 总经理：张阿斌 首席科学家：Yuan Lu 财务总监：许骥 董事会秘书：徐永文 证券事务代表：孙玉华

	<p>证券投关高级经理：刘妍君</p> <p>证券事务专员：林彦凌</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>第一部分：上市公司介绍基本情况</b></p> <p>赛微电子创始人、实控人、董事长杨云春博士介绍了公司主营 MEMS 业务所在行业的发展态势，瑞典 Silnex 重大交易的考虑，公司的产业链生态布局以及全球化发展战略规划；</p> <p>赛微电子副总经理、首席科学家 Yuan Lu 博士介绍了公司所拥有的硬件设施、研发方向、知识产权、代表性及前沿工艺技术以及已构建的 MEMS 共性关键技术工具箱；</p> <p>赛微电子董事、总经理张阿斌介绍了公司其他方面的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、瑞典交易具体细节以及 2026 年 Q1 经营情况；</p> <p>杨云春博士、Yuan Lu 博士、张阿斌先生、徐永文先生、许骥先生回答了投资者关心的问题，并组织安排了工厂洁净间参观活动。</p> <p><b>第二部分：上市公司解答投资者提问，主要如下：</b></p> <p><b>1、请介绍下公司的整体战略规划，未来北京工厂发展过程中公司需要重点关注并加强的工作。</b></p> <p>答：对于整体战略规划，公司将基于当前国际局势紧张及日趋复杂化的考量，面对经济全球化与国际产业链分工协作可能面临的挑战，积极拉通内部各业务板块，发挥资源及组织的协同效应，同时在境内外布局建立包括 MEMS 纯代工制造及 IC 服务在内的业务平台，以同时满足境内外客户的不同需求，致力于形成可支持“内循环”、兼顾“双循环”的半导体服务体系；同时积极进行半导体产业投资布局，面向客户提供从 IC 设计服务及 EDA 工具、工艺开发、晶圆制造到封装测试的一站式综合服务，努力发展成一家立足本土、国际化经营的知名半导体</p>

专业服务厂商。

北京工厂的具体工作而言，未来北京工厂发展过程中，我们需要关注的工作有很多，但尤其重点的有以下几方面，第一，公司需要继续积极拓展市场，紧跟市场客户需求，扩大公司代工服务品类；第二，公司要持续不断进行工艺积累和技术突破，提升代工品类的良品率及稳定性；第三，公司要不断推进代工产品从工艺开发向晶圆制造、从小批量市场向规模量产的迁移跨越。对未来北京工厂发展过程中的其他工作，我们也会时刻保持关注。

## **2、公司如何看待 MEMS 行业的纯代工模式及 IDM 模式？**

答：在我们看来，每家公司的业务发展模式都是根据自身的业务情况确定的，公司非常尊重各类厂商（包括客户）自身的战略考虑。但同时我们也应看到，半导体制造产线的建设具有长周期、重资产投入的特点，且某单一领域设计公司投资建设的自有产线一方面较难为同类竞争设计公司服务，另一方面产线向其他产品品类拓展的难度也较大。而公司是专业的纯代工企业，基于长期的工艺开发及生产实践，在同类产品的代工业务方面能够积累较好的工艺技术，在制造环节具有产品迭代和成本控制方面的服务优势，Fabless（无晶圆厂）模式或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司与我们合作，可以避免巨大的固定资产投资，可以将资源更多地专注在产品设计及迭代方面，并参与市场竞争。

综合而言，IDM 模式与 Fabless 或 Fablite 模式（对应与纯 Foundry 厂商合作）相比各有优劣，将会是业界长期共存的商业发展模式。公司的纯代工模式虽然具有“重资产投入、长周期回报、价值段限于代工、被动应对客户需求”等缺点，但同时也具有“行业门槛高、合理具备预见基础、专注代工可做精做深、与客户无利益冲突”等优点。

### **3、公司自身 MEMS 专业纯代工定位为什么有利于代工品类的扩展？**

答：公司始终坚持并严格执行专业化纯代工（Pure-Foundry）模式，不涉足自有芯片品牌的研发、设计与销售，完全聚焦于制造环节，为客户提供稳定、可靠、可规模化的 MEMS 纯代工服务。就如前面所说，纯代工定位与客户不存在利益冲突，有利于双方建立长期稳定互信的合作关系，对于半导体的设计与制造合作而言至关重要。

基于商业模式，公司建立了完善的知识产权保护机制与信息安全体系，可有效保障客户核心 IP、设计方案与关键技术不被泄露、不被滥用，让客户在与公司进行技术合作与量产落地过程中具备高度安全感。公司确保了与合作客户合作关系的纯粹性与稳定性，在潜在客户拓展与纯代工品类延伸方面具备独特的竞争优势。

### **4、请问公司如何看待 MEMS 行业未来的市场规模？**

答：随着万物互联与智能传感时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，无论科技及应用如何发展，均离不开对真实世界的感知，人、设备、自然世界之间及内部各自之间的感知、联系均需要通过声、热、光、电、磁、运动等等各种基础器件来辅助实现，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代。我们认为，基于“软硬件一体配比”的逻辑，相较于 IC 芯片产业的规模体量，MEMS 芯片产业仍处于发展初期，未来发展前景广阔。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿

美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）为 3.7%。

**5、请问 MEMS 行业当前的发展情况及竞争格局如何？**

答：随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的 MEMS 获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件逐步被替代，MEMS 技术的渗透率得以进一步提高。目前，MEMS 行业 Foundry 模式与 IDM 模式并存，代工企业通过支持 Fabless、Fablite 设计公司快速创新，推动 MEMS 生态发展。

总体来看，MEMS 行业正处于关键发展期，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。

**6、公司的主要竞争对手有哪些？MEMS 在哪些重点领域国产替代推进较快？**

答：公司在 MEMS 产业链中拥有清晰的角色定位及充分的发展定力，是国内业界领先、极少数以 Pure-Foundry 模式运营的 MEMS 芯片专业制造厂商。公司 MEMS 主业直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、惠普、意法半导体、德州仪器等 IDM 企业，也包括 Teledyne、台积电、X-FAB、索尼、Atomica 等境外代工企业，以及芯联集成、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微、华鑫微纳等含 MEMS 业务的境内企业。

截至目前，不同 MEMS 应用领域的竞争格局存在不同差异，通信计算、生物医疗、工业汽车和消费电子领域的中高端市场已经开始出现及深化国产替代，未来具有广泛发展空间。

**7、请问北京工厂目前 MEMS-OCS 晶圆是否实现量产？具体客户是哪些公司？**

答：公司北京工厂为某客户代工的 MEMS-OCS 已于 2025 年 8 月

进入试产阶段，期间经过多轮更新迭代，但截至目前尚未实现量产。需要说明的是 MEMS-OCS 属于一类晶圆的统称，包括不同具体类别及客户，公司将包括 MEMS-OCS 在内的硅光领域作为特色代工业务的重要战略布局方向。截至目前，北京工厂所代工的 MEMS-OCS 晶圆主要提供给国内客户，但受限于协议条款保密要求，公司不便透露客户的具体信息，敬请谅解。

**8、在 2025 年 8 月进入试产之后，北京工厂 MEMS-OCS 现在的进展如何，预计什么时间可以实现量产放量？**

答：2025 年 8 月公司试产 MEMS-OCS 并向客户交付以来，公司持续和客户沟通对接，但公司主要从事的是 MEMS 代工环节，处在产业链的上游，直接客户以 MEMS 芯片设计企业为主，并不直接触及 MEMS-OCS 代工品类的应用终端；而现实情况是，应用终端往往需要对包括 MEMS-OCS 在内的众多集成软硬件进行系统测试，在此过程中需要验证和排除的因素众多，不仅仅包括公司所在的核心器件代工环节，还包括模组、硬件、系统等在横向与纵向角度同样影响稳定性、可靠性等的一系列产业链友商环节，最终验证需要产业链各环节信息之间的不断拉通、反馈、验证，客观上需要一定时间。且由于 MEMS-OCS 属于新兴领域的复杂结构器件，客户往往结合下游具体应用需求，同时推动多款不同设计以及随时进行迭代更新，涉及公司工艺实现层面的反复支持，也是影响从试产到量产定型进程的一大因素。

公司十分理解广大投资者对公司重点代工产品的关注，目前正与上下游产业链紧密合作，努力推进 MEMS-OCS 从试产向量产所需的一系列工作。但也正因为明星产品所客观存在的难度及挑战性，需要尊重工程科学的客观性与严谨性。

**9、瑞典 Silex 的上市进展如何？预计什么时间可以完成？**

答：瑞典 Silex 正快速推动在境外上市事宜，瑞典 Nasdaq Stockholm（纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所）上市委员会已评估确认，瑞典 Silex 符合上市条件；后续在满足常规条件及完成标准程序后，将批准瑞典 Silex 的上市申请。瑞典 Silex 的 IPO 上市预计将于 2026 年上半年内完成，具体以瑞典 Silex 的实际工作情况为准。

公司将根据该事项进展及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

**10、公司持有的剩余瑞典 Silex 45.24%股权怎么安排？对于转让瑞典 Silex 控制权及后续股权处置收到的款项，公司有何使用计划？**

答：为共同推动瑞典 Silex 的 IPO 上市、业务开拓及长远发展，亦为兼顾短中长期目标、最大化维护公司及全体股东利益，以及统筹规划公司未来发展战略，在充分沟通协商基础上，公司对所持瑞典 Silex 的 45.24%股权做了系统安排。

首先，公司拟将目前持有的瑞典 Silex 45.24%普通股扣除瑞典 Silex 上市后公司继续持有的 9.90%普通股及瑞典 Silex 上市后公司转让给 Bure 的瑞典 Silex 19.10%普通股的差额持股部分，在瑞典 Silex 上市时预计以瑞典 Silex 上市发行前全部普通股 78.96 亿瑞典克朗（SEK）的估值进行 IPO 配售；第二，对公司转让给 Bure 的瑞典 Silex 19.10%普通股，将在瑞典 Silex 首次公开募股锁定期承诺届满（锁定期拟定 180 天，具体以最终实际情况为准）至公司与 Bure 双方约定时间内，由公司决策后，指令 Bure 协助择机出售；第三，瑞典 Silex 本次上市及发行普通股后，公司仍将持有瑞典 Silex 9.90%普通股，在锁定期满后可以选择进行出售或长期持有。

关于本次股权出售所获资金，公司将进行谨慎使用，优先用于支持保障公司当前核心主业的发展，其次用于在半导体综

合服务领域的中长期布局。

**11、瑞典 Silex 上市以及公司进一步出售瑞典 Silex 股权对公司今年以及以后业绩有何影响？**

答：瑞典 Silex 若上市成功及公司转让瑞典 Silex 部分股权实施落地，在扣除相关费用及成本后预计将对公司年度利润表科目产生正向影响（尚无法核算准确金额），给公司带来可观的现金资产和流入。剩余持股的中长期收益情况将取决于瑞典 Silex 自身的业务发展情况以及上市后所处资本市场的整体环境，有待后续的持续跟踪观察。当然公司也非常清楚，当前最为核心的是尽快推动促进公司本土 FAB 的建设运营、业务发展及业绩增长。

**12、请问贵公司北京工厂未来的产品规划是怎样的，以及目前的客户分布情况如何？**

答：北京工厂已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，正在进行气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元（IMU）、温湿度、硅晶振、MEMS-OCS 等 MEMS 器件的小批量试产，同时对于微流控、压力、磁性传感、3D 硅电容等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。北京工厂将继续做好中长期规划，密切关注市场环境动态，深化全国重点区域布局，注重分析产品在不同应用领域的工艺特点，持续提升运营能力。公司北京工厂目前群体以国内为主，同时我们也不排除海外客户有可能带来的订单和机会。

**13、请介绍下公司对先进封装测试业务、IC 设计服务业务的规划。**

答：公司封测产线已于 2025 年 12 月投入使用但目前尚处于起

步阶段。现阶段该产线在公司 MEMS 基地（北京工厂）内独立建设运营，已有序开展客户需求对接、工艺技术研发、产品小批量试制等工作，同时持续完善专业技术团队搭建，相关配套设备采购工作已落地推进。后续公司将充分依托在 MEMS 纯代工领域长期积累的成熟工艺经验及客户资源优势，结合自身在半导体制造环节的技术积淀与运营管理能力，持续加大封装测试业务的技术研发、产能优化与市场开拓力度，稳步提升封测工艺水平，不断丰富服务品类、完善业务布局，推动封装测试业务逐步实现良性发展与规模提升。当然与代工业务的过往类似，该项业务也需要经历一个从 0 到 1 逐步积累的过程。

#### **14、请介绍下公司对 IC 设计服务业务的规划。**

答：公司 IC 设计服务业务，是指以芯片设计公司为主的客户在提出芯片具体功能要求后，公司（控股子公司青岛展诚）协助其进行相关产品定义、架构设计、工艺选型、IP 选型、电路设计、仿真、物理设计以及量产流片等相关设计服务工作。同时，基于客户需求，公司也开始向客户少量提供 EDA 软件开发和技术支持服务。

对于这块业务，在 2025 年 8 月的并购交易中，青岛展诚对 2025、2026、2027 三年业绩作出承诺，2025 年业绩承诺已顺利实现。并表之后，公司与青岛展诚进行了良好的对接与整合，也在公司资源框架内对其业务进行了充分支持，IC 设计服务业务已开始成为公司新的收入及业绩贡献点。

#### **15、公司北京亦庄 MEMS 产线的产能利用率仍处于较低水平，公司对此有何规划？**

答：与 IC 产线的标准化流程不同，MEMS 产线涉及晶圆类别众多、工艺及材料纷繁复杂。公司北京亦庄产线当前的主要工作在于，积极推动硅麦克风、BAW 滤波器、MEMS 微振镜、MEMS

高频器件等产品的量产爬坡，以及 MEMS 气体、生物芯片、加速度计、惯性 IMU、温湿度、MEMS-OCS、硅晶振等产品的风险试产；同时陆续推动微流控、压力、磁性传感、3D 硅电容等 MEMS 芯片、器件及模块的工艺开发；未来随着客户及订单需求的持续增加，公司需要更加重视工艺及良率提升，特别关注保障产能爬坡过程中的一致性 & 稳定性，才能推动产能利用率的持续提升。

另外，由于 MEMS 行业高度定制化、验证试产之后才有量产的客观规律，MEMS 产线将根据晶圆系列规划陆续有针对性地扩充产能，在共线生产情况下的产能利用率也一般低于 CMOS 标准产线，同时在一定时期往往存在“产能等待订单”的状态。公司客观理性看待北京 MEMS 产线所处发展阶段，既理解短期较低的产能利用率水平，又对中长期产能利用率的持续提高充满信心。

**16、贵司今日股价大幅下跌，市场普遍认为 2026 年第一季度业绩不及预期为主要原因，公司此前为何不考虑披露 2026 年一季度业绩预告？**

答：的确，公司股价在今日大盘及板块调整的大背景下出现了远超公司预期的大幅波动，成交量与换手率均急剧放大。二级市场股价影响因素众多且复杂，自 2025 年 11 月以来，公司股价已呈现大幅波动、交易活跃的显著特征，今日股价的大幅下跌，公司认为属于该等特征的延续，业绩为影响因素之一。

公司 2025 年 7 月完成了瑞典 Sillex 控制权出售交割，瑞典 Sillex 出表后，公司必然面临收入下降以及利润亏损（扣除非经常性损益后）的客观挑战。公司也分别在 2025 年第三季度报告和 2025 年年报中向投资者展示并提示了相关内容。

2026 年第一季度公司业绩同比大幅下滑，主要是因为瑞典 Sillex（此前长期以来为公司 MEMS 业务的核心构成部分）

	<p>在 2025 年第一季度仍在公司合并报表范围内，而 2026 年第一季度瑞典 Silex 不再纳入合并报表范围，该影响因素在 2025 年 7 月瑞典 Silex 股权交割完成时已较为清晰。虽然北京工厂的 MEMS 代工收入在 2026 年第一季度较 2025 年第一季度已实现显著增长，但由于绝对金额体量较小，难以对冲瑞典产线出表对公司 MEMS 业务体量及业绩所带来的巨大冲击。</p> <p>根据深交所创业板相关规则，业绩预告仅对年度报告特定情形具有法定强制披露规定，基于严谨及避免误导角度考虑，公司近三年来均未披露季度业绩预告。本次未披露 2026 年一季度业绩预告，系公司结合监管规定及信息披露一致性原则综合审慎考虑所作出的安排。</p> <p>公司奉行长期主义，既然选择了纯代工制造这条路，即使仍面临着各种各样的挑战和困难，公司团队将继续努力奋斗，积极挖掘市场、服务客户，聚沙成塔、一步一个脚印，为股东创造坚实的长期价值，希望各位投资者能够给予公司更多耐心与支持。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 4 月 23 日